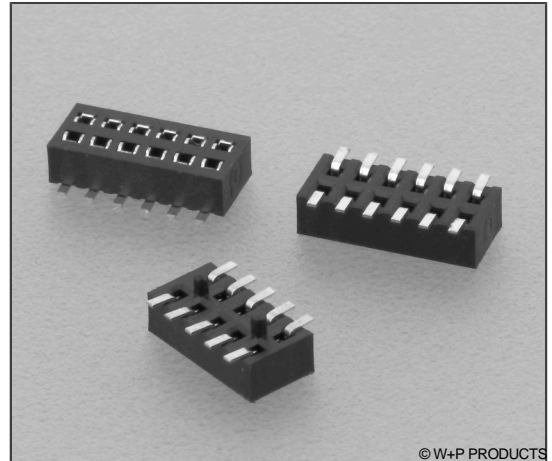


## SMT-Buchsenleisten RM 1,27mm, stehend, 2-reihig – BH 2,2mm, von unten steckbar SMT Female Headers, 1.27mm Pitch, Vertical, Double Row – 2,2mm, Bottom Entry

### Technische Daten / Technical Data

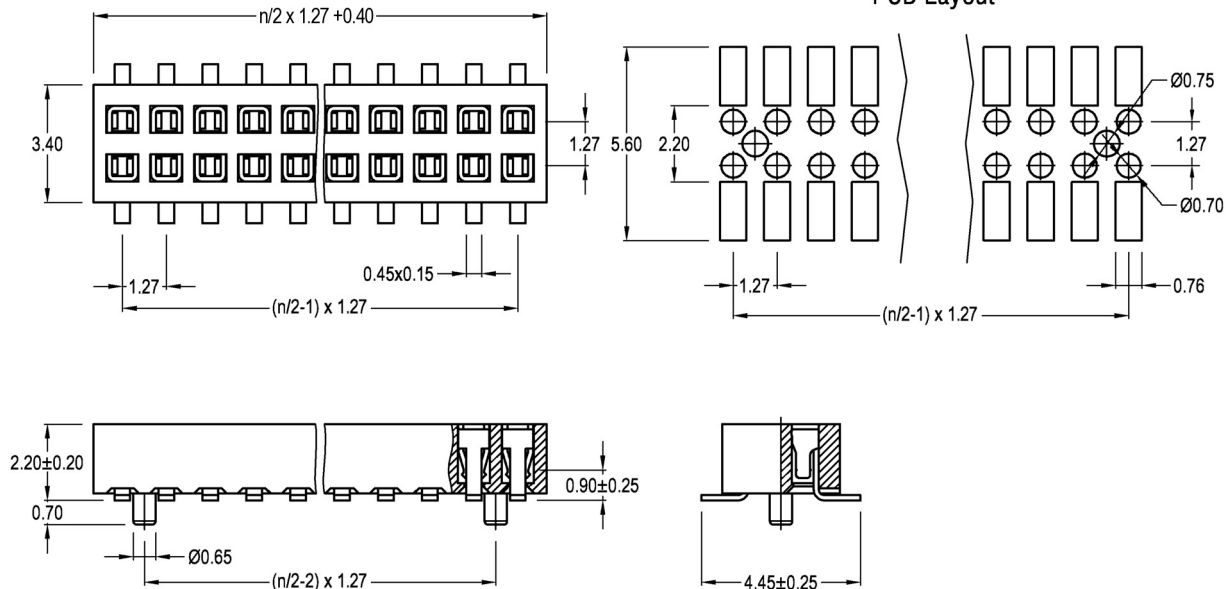
Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
<i>Insulator</i>	<i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
<i>Contact Material</i>	<i>Copper alloy</i>
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)
<i>Contact Surface</i>	<i>Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)</i>
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
<i>Contact Resistance</i>	<i>&lt; 20 mΩ</i>
Isolationswiderstand	> 500 MΩ
<i>Insulation Resistance</i>	<i>&gt; 500 MΩ</i>
Spannungsfestigkeit	500 V AC
<i>Test Voltage</i>	<i>500 V AC</i>
Nennstrom	1 A
<i>Current Rating</i>	<i>1 A</i>
Temperaturbereich	-40 °C ... +105 °C
<i>Temperature Range</i>	<i>-40 °C ... +105 °C</i>
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren
<i>Processing</i>	<i>Reflow soldering</i>



© W+P PRODUCTS

Doppelfederkontakte für Vierkantstifte 0,40mm.  
Dual beam contacts accept 0.40mm square pins.

### PCB Layout



<b>Series</b>	<b>Contacts*</b>	<b>Plating*</b>	<b>Locating Pegs*</b>	<b>Packaging*</b>
<b>6061</b>	<b>040</b> 006-080 Zweireihig Double row	<b>00</b> 00 Vergoldet Gold plated 50 Verzinkt Tin plated	<b>10</b> 00 Ohne Pos.hilfen W/o loc. pegs 10 Mit Pos.hilfen With loc. pegs	<b>PPST</b> ST PPST PPTR

### Lieferformen / Packaging Options:

**ST** In Stangen ohne Pick&Place-Pads / In tubes w/o Pick&Place-Pads  
**PPST** In Stangen mit P&P-Pads / In tubes with P&P-Pads  
**PPTR** Tape & Reel mit P&P-Pads / Tape & Reel with P&P-Pads

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
 \* This is an **order example** - please replace by your specifications.

## Informationen zum Reflow-Lötverfahren Reflow Soldering Information

### Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150 °C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217 °C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur $T_P$	max. 8m

### Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150 °C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217 °C
Duration above $T_L$	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature $T_P$	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	max. 8min

